

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Tomoyuki MAEDA, et al.

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: MAGNETIC RECORDING MEDIUM

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231



SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY

Japan

APPLICATION NUMBER

2001-012119

MONTH/DAY/YEAR

January 19, 2001

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Norman F. Oblon

Registration No. 24,618

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124



22850

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

J1050 U.S. PTO
10/050118
01/18/02

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 1月19日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-012119

出 願 人

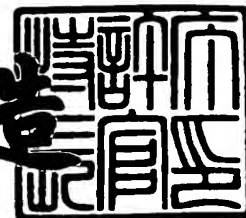
Applicant(s):

株式会社東芝

2001年 9月 5日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3081996

【書類名】 特許願

【整理番号】 A000007021

【提出日】 平成13年 1月19日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G11B 5/62

【発明の名称】 磁気記録媒体

【請求項の数】 4

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研
究開発センター内

【氏名】 前田 知幸

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研
究開発センター内

【氏名】 喜々津 哲

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研
究開発センター内

【氏名】 永瀬 俊彦

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研
究開発センター内

【氏名】 秋山 純一

【特許出願人】

【識別番号】 000003078

【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】 100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9705037

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気記録媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板と、該基板上に形成された下地層と、該下地層上に形成された磁性層と、該磁性層上に形成された保護層とを具備し、前記磁性層は Fe および Pt を主成分とする $L1_0$ 構造を有する結晶粒からなり、該結晶粒内に Cu、Au、Zn、Sn および Pd からなる群より選択される少なくとも一種の元素が 0.1 から 50 原子パーセントの範囲で存在していることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項 2】 基板と、該基板上に形成された下地層と、該下地層上に形成された磁性層と、該磁性層上に形成された保護層とを具備し、前記磁性層は Fe および Pd を主成分とする $L1_0$ 構造を有する結晶粒からなり、該結晶粒内に Cu、Au、Zn および Sn からなる群より選択される少なくとも一種の元素が 0.1 から 50 原子パーセントの範囲で存在していることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項 3】 基板と、該基板上に形成された下地層と、該下地層上に形成された磁性層と、該磁性層上に形成された保護層とを具備し、前記磁性層は Co および Pt を主成分とする $L1_0$ 構造を有する結晶粒からなり、該結晶粒内に Ni および Au からなる群より選択される少なくとも一種の元素が 0.1 から 50 原子パーセントの範囲で存在していることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項 4】 7 kOe 以上の保磁力を有することを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、高密度磁気記録に適する磁性膜を備えた磁気記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年のコンピュータの処理速度向上に伴って、情報の記憶・再生を行う磁気記

憶装置（HDD）には高速・高密度化が要求されている。これに伴い、多粒子系の磁気記録媒体において磁性粒子の孤立化・微細化が進んだ結果、近年熱揺らぎによる記録磁化の劣化が問題となってきた。磁気記録媒体の熱揺らぎ耐性の指標として一般に KuV/kT （ここで Ku 、 V 、 k 、 T はそれぞれ、磁気異方性エネルギー、磁化反転における活性化体積、ボルツマン定数、絶対温度を表わす）が用いられる。この値が 80 以上であれば、その磁気記録媒体は熱的に安定であるとされている。高密度化に伴って磁性微粒子の粒径が約 3 nm、膜厚が約 10 nm 程度まで微細化が進むとすると、 10^7 erg/cc 以上の高 Ku が必要となる。室温で高 Ku を有する磁性材料としては、FePt、FePd、CoPt といった規則相合金系材料が知られており、これらの材料を磁性層として用いることにより熱揺らぎ耐性を著しく高めることができる。これらの材料は、面心正方格子（fcc）において $\{001\}$ 面を磁性元素が、 $\{002\}$ 面を貴金属元素が（あるいは $\{002\}$ 面を磁性元素が、 $\{001\}$ 面を貴金属元素が）それぞれ占める、 $L1_0$ 型（CuAu-I 型）構造といわれる結晶構造をとった場合のみ、その c 軸方向に非常に大きな Ku が発現する。しかし、スパッタリングや電子ビーム蒸着といった HDD 媒体作製プロセスで通常用いられる成膜法のみでは、前述の結晶構造を有する規則相を形成することができない。ほぼ完全な規則相を形成するには、基板を 500℃ 以上の高温に加熱した状態で成膜を行うか、または成膜後に 500℃ 以上の高温で熱処理（アニール）を行う必要がある。しかし、現行の HDD 媒体の生産プロセスにおいて通常用いられている成膜装置では、このような高温のプロセスは現実的ではない。したがって、規則相合金系材料を用いた磁気記録媒体の実用化には、基板温度またはアニール温度の低温化が必要である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

上述したように、熱揺らぎ耐性を高める材料として規則相合金系材料は有望であるが、その実用化には規則化に必要な基板温度またはアニール温度を低下させる必要がある。

【0004】

本発明の目的は、規則相形成に必要な基板温度またはアニール温度を低減させることができる磁気記録媒体を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明の磁気記録媒体は、基板と、該基板上に形成された下地層と、該下地層上に形成された磁性層と、該磁性層上に形成された保護層とを具備し、前記磁性層はFeおよびPtを主成分とする $L1_0$ 構造を有する結晶粒からなり、該結晶粒内にCu、Au、Zn、SnおよびPdからなる群より選択される少なくとも一種の元素が0.1から50原子パーセントの範囲で存在していることを特徴とする。

【0006】

本発明の他の磁気記録媒体は、基板と、該基板上に形成された下地層と、該下地層上に形成された磁性層と、該磁性層上に形成された保護層とを具備し、前記磁性層はFeおよびPdを主成分とする $L1_0$ 構造を有する結晶粒からなり、該結晶粒内にCu、Au、ZnおよびSnからなる群より選択される少なくとも一種の元素が0.1から50原子パーセントの範囲で存在していることを特徴とする。

【0007】

本発明の磁気記録媒体は、基板と、該基板上に形成された下地層と、該下地層上に形成された磁性層と、該磁性層上に形成された保護層とを具備し、前記磁性層はCoおよびPtを主成分とする $L1_0$ 構造を有する結晶粒からなり、該結晶粒内にNiおよびAuからなる群より選択される少なくとも一種の元素が0.1から50原子パーセントの範囲で存在していることを特徴とする。

【0008】

本発明の磁気記録媒体は7kOe以上の保磁力を有することが好ましい。

【0009】

【発明の実施の形態】

本発明の磁気記録媒体は図1に示す構造を有する。図1に示すように、基板1上に、下地層2、磁性層3および保護層4が順次積層されている。

【0010】

本発明において用いられる基板は、ガラス、セラミックス等の非晶質または多結晶の材料が望ましい。ここで、多結晶基板とは、結晶内に一つ以上の結晶粒界が存在する結晶のことである。また、硬質の材料からなる基板に金属またはセラミックス等を堆積したものを基板とすることもできる。

【0011】

本発明に用いられる下地層は磁性層の磁気記録媒体としての機能を補強するものである。具体的には、磁性層と基板との間に挿入される薄膜であり、一つの材料系からなる層でもよいし、いくつかの層から構成される多層膜であってもよい。下地層は一部分が前記の条件を満たしているものであれば、薄膜状である必要もない。

【0012】

本発明に用いられる磁性層は、磁性金属元素および貴金属元素を主成分とし $L1_0$ 型構造を有する規則合金結晶粒中に、一種以上の添加元素を固溶させたものである。 $L1_0$ 型 ($CuAu-I$ 型) 構造とは、面心正方格子 (fcc) において $\{001\}$ 面を磁性元素が、 $\{002\}$ 面を貴金属元素が (あるいは $\{002\}$ 面を磁性元素が、 $\{001\}$ 面を貴金属元素が) それぞれ占める結晶構造のことをいう。なお、 $L1_0$ 構造は二元系合金の結晶構造の一つであり、添加元素を固溶させた3元系以上の合金は厳密には $L1_0$ 構造とはいえないが、本発明においては主成分である磁性元素と貴金属元素の2元素からなる副格子が $L1_0$ 構造をとっている場合には、その結晶構造は $L1_0$ 構造であるとみなしている。また、磁性層の全体が完全に $L1_0$ 型構造をとっている必要はなく、磁性層中において規則相 ($L1_0$ 構造を有する相) の不規則相に対する体積比が1:1以上であれば十分である。

【0013】

上記のように、磁性層は磁性元素と貴金属元素と添加元素を含有する。本発明で用いられる添加元素は、以下のような性質を有する。すなわち、添加元素と磁性元素との固溶熱 (エンタルピー) と、添加元素と貴金属元素との固溶熱が互いに異符号となるような添加元素が用いられる。添加元素は1種または2種以上用

いてもよい。合金系を正則溶体とみなした場合、一般にA-B二元系合金間の固溶熱 ΔH_{A-B} は次のように表わされる。

【0014】

$$\Delta H_{A-B} = x_A x_B \Omega_{AB}$$

ここで、 x_A 、 x_B はそれぞれA、Bのモル分率、 Ω_{AB} は相互作用パラメーターと呼ばれる物理量である。A-A、B-B、A-B原子対の結合エネルギーをそれぞれ E_{AA} 、 E_{BB} 、 E_{AB} とすると、 Ω_{AB} は $\{E_{AB} - (E_{AA} + E_{BB}) / 2\}$ に比例する。 $\Omega_{AB} > 0$ すなわち $\Delta H_{A-B} > 0$ のときA原子とB原子は互いに反発し、 $\Omega_{AB} < 0$ すなわち $\Delta H_{A-B} < 0$ のときA原子とB原子は互いに引き合う傾向にある。したがって、添加元素は磁性元素および貴金属元素の一方と反発し、他方と引き合う傾向にある元素である。

【0015】

このような添加元素Xを例えばFePt結晶粒に添加すると、図2に示すような $L1_0$ 型構造をとる。この図に示されるように、最近接サイトに添加原子Xと引き合う傾向にあるA(Pt)原子が配置され、第二近接サイトにX原子と反発する傾向にあるB(Fe)原子が配置されている。一方、図3にA(Pt)原子とB(Fe)原子が不規則に配置されている構造を示す。このように添加元素XをFePt結晶粒に添加した場合には、図2の $L1_0$ 型構造をとる方が、図3の不規則な構造をとるよりも安定になるため、規則化の駆動力が増大する。したがって、磁性元素と貴金属元素に添加元素を添加した場合には、添加しない場合に比べて低温で規則化させることができる。

【0016】

次に、本発明に用いられる磁性層の構成元素について、より詳細に説明する。

Fe-Pt系合金に対しては、Cu、Au、Zn、SnおよびPdからなる群より選択される少なくとも一種の元素が添加される。これらの添加元素はいずれも、Feとの固溶熱が正の値を示し、かつPtとの固溶熱が負の値を示す。したがって、添加元素の添加効果によりFePtの規則化が促進され、FeおよびPtを主成分とする $L1_0$ 型構造を有する結晶粒中に上記添加元素が固溶した構造

が得られる。添加元素の F e P t 結晶粒中への固溶量は 0. 1 ~ 5 0 原子パーセントの範囲であることが好ましい。添加元素の固溶量が上記の範囲であれば、磁性層の K u が大きくなる。また、F e : P t の組成比は 4 : 6 ~ 6 : 4 の範囲にあることが好ましい。組成比が上記の範囲であれば、L 1₀ 構造を有する規則相が形成される。

【 0 0 1 7 】

F e - P d 系合金に対しては、C u、A u、Z n および S n からなる群より選択される少なくとも一種の元素が添加される。これらの添加元素はいずれも、F e との固溶熱が正の値を示し、かつ P d との固溶熱が負の値を示す。したがって、添加元素の添加効果により F e P d の規則化が促進され、F e および P d を主成分とする L 1₀ 型構造を有する結晶粒中に上記添加元素が固溶した構造が得られる。添加元素の F e P d 結晶粒中への固溶量は 0. 1 ~ 5 0 原子パーセントの範囲であることが好ましい。添加元素の固溶量が上記の範囲であれば、磁性層の K u が大きくなる。また、F e : P d の組成比は 4 : 6 ~ 6 : 4 の範囲にあることが好ましい。組成比が上記の範囲であれば、L 1₀ 構造を有する規則相が形成される。

【 0 0 1 8 】

C o - P t 系合金に対しては N i および A u からなる群より選択される少なくとも一種の元素が添加される。これらの添加元素はいずれも、C o との固溶熱が正の値を示し、かつ P t との固溶熱が負の値を示す。したがって、添加元素の添加効果により C o P t の規則化が促進され、C o および P d を主成分とする L 1₀ 型構造を有する結晶粒中に上記添加元素が固溶した構造が得られる。添加元素の F e P d 結晶粒中への固溶量は 0. 1 ~ 5 0 原子パーセントの範囲であることが好ましい。添加元素の固溶量が上記の範囲であれば、磁性層の K u が大きくなる。また、C o : P t の組成比は 4 : 6 ~ 6 : 4 の範囲にあることが好ましい。組成比が上記の範囲であれば、L 1₀ 構造を有する規則相が形成される。

【 0 0 1 9 】

磁性層が規則構造をとっているか否かは、X線回折や電子線回折で確認することができる。磁性層が規則構造をとっている場合、不規則 f c c 構造では現れな

い(001)、(110)、(003)といった面からの回折ピークや回折スポットが観測される。

【0020】

なお、特開平9-320847号公報には、規則相合金に元素を添加することが開示されている。しかし、この公知例では実質的に磁性元素としてFeおよびCoを含有する合金しか記載されていない。しかも、この公知例では添加元素の添加量を規定しているものの、合金結晶中における添加元素の存在位置についての記載がなく、添加元素が規則合金に固溶している量と規則合金の結晶粒界などに析出している量が区別されていない。合金の規則化を促進するには添加元素が規則合金と固溶することが必要であり、したがって公知例に開示されている条件のみでは規則化を促進することはできない。また、公知例に開示されている添加元素には添加によってむしろ規則化を妨げる働きをする元素もふくまれており、したがって上記公知例に開示されている条件のみでは規則化に必要な基板温度またはアニール温度を低下させることはできない。また、公知例に開示されている添加元素には添加によってむしろ規則化を妨げる働きをする元素も含まれている。したがって、上記公知例の開示からは、規則化に要する基板温度またはアニール温度を低下できるという効果は示唆されない。

【0021】

本発明では添加元素の規則合金結晶中の固溶量を規定している。この場合、添加元素の固溶量とは、規則合金結晶粒内に存在する添加元素の量であり、結晶粒界などに存在する添加元素を含まない。規則合金結晶粒内の添加元素の同定および存在量の測定は分析TEM（透過型電子顕微鏡）などによって行うことができる。

【0022】

本発明における磁性層の厚さはシステムの要求値によって決定されるが、一般的に200nmよりも薄いことが好ましく、50nmより薄いことがより好ましい。ただし、0.5nmより薄いと連続膜とならず磁気記録媒体には適さない。

【0023】

本発明の磁気記録媒体を構成する各種薄膜の成膜方法としては真空蒸着、各種

スパッタリング、化学気相成長、レーザーアブレーションを用いることができる。特に、磁性層は圧力 5 m T o r r 以上の雰囲気下でスパッタリングにより成膜することが好ましい。下地層や磁性層の成膜の際には、基板に R F や D C 電力を投入するバイアススパッタ、基板へのイオンや中性子の照射などを行ってもよい。これらの処理は成膜中のみならず成膜後または成膜前に行っても構わない。

【 0 0 2 4 】

【実施例】

本発明の実施例について説明する。

【 0 0 2 5 】

実施例 1

ガラス基板上に、M g O からなる厚さ 1 0 n m の下地層、厚さ 5 0 n m の磁性層、およびカーボンからなる厚さ 5 n m の保護層を成膜した。形成した磁性層は、 $Fe_{1-x}Pt_x$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Cu)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Pd)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Au)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Sn)$ または $Fe_{1-x}Pt_x(Zn)$ である。M g O 下地層は R F スパッタリングにより、磁性層および保護層は D C スパッタリングにより成膜した。磁性層は 5 m T o r r 以上の圧力で二元または三元同時スパッタリングにより成膜し、その組成は各ターゲットへの投入電力を変化させて制御した。成膜中、基板の加熱は行わなかった。成膜後、水素雰囲気中で 3 0 0 ~ 7 0 0 ° C の範囲で 1 時間のアニールを行った。

【 0 0 2 6 】

アニール後に磁性層を構成する規則合金結晶の規則度 S を X 線回折法により評価した。規則度 S は、X 線回折によって得られた (0 0 1) および (0 0 2) 面による回折ピークの積分強度に基づいて次式により評価した。

【 0 0 2 7 】

$$S = 0.72 (I_{001} / I_{002})^{1/2}$$

ここで、 I_{001} および I_{002} はそれぞれ (0 0 1) および (0 0 2) 面による回折ピークの積分強度である。

【 0 0 2 8 】

磁性層のアニール後に、透過型電子顕微鏡 (T E M) を用いた E D X による規

則合金結晶粒内の局所分析によって結晶粒内に存在する添加元素の量を測定し、結晶粒中への添加元素の固溶量 y [at %] とした。媒体の磁気異方性エネルギー K_u はトルク磁力計を用いて室温で測定した。媒体の膜面に垂直な方向における保磁力は SQUID を用いて室温で測定した。

【0029】

図4は、 $Fe_{1-x}Pt_x$ 磁性層について、組成 x と $500^\circ C$ でアニールした後の規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.4 \leq x \leq 0.6$ の範囲で規則合金結晶の規則度が向上することがわかった。また、 $Fe_{1-x}Pt_x(Cu)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Pd)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Au)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Sn)$ および $Fe_{1-x}Pt_x(Zn)$ のそれぞれの磁性層も、添加元素の固溶量にかかわらず上記と同様の傾向を示した。

【0030】

図5は、 $x = 0.5$ 、添加元素の固溶量 $y = 6$ at % である、 $Fe_{1-x}Pt_x$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Cu)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Pd)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Au)$ 、 $Fe_{1-x}Pt_x(Sn)$ および $Fe_{1-x}Pt_x(Zn)$ のそれぞれの磁性層について、アニール温度と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $FePt$ 磁性層ではアニール温度 $300^\circ C$ では規則化が起こらずアニール温度 $400^\circ C$ 以上で規則化が起こる。 $FePt$ に添加元素を添加した磁性層ではいずれもアニール温度 $300^\circ C$ 以上で規則化が起こる。このように、添加元素の添加により低いアニール温度で結晶粒の規則化が起こることがわかった。

【0031】

図6は、 $300^\circ C$ でアニールされた $x = 0.5$ である $Fe_{1-x}Pt_x(Cu)$ 磁性層について、結晶粒内への Cu の固溶量 y [at %] と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で規則度の向上が確認された。他の添加元素についても同様の結果が得られた。

【0032】

図7は、 $300^\circ C$ でアニールされた $x = 0.5$ である $Fe_{1-x}Pt_x(Cu)$ 磁性層について、結晶粒内への Cu の固溶量 y [at %] と基板面に対して垂直方向の K_u との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で $1 \times 10^7 \text{ erg/cc}$ 以

上の高Kuが得られた。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Pd)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Au)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Sn) および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Zn) のいずれの磁性層でも同様の結果が得られた。

【0033】

図8は、 $x=0.5$ 、 $y=6\text{at}\%$ である、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Cu)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Pd)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Au)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Sn) および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Zn) のそれぞれの磁性層について、アニール温度と保磁力との関係を示す。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 以外の全ての磁性層において、 300°C 以上のアニール温度で 7kOe 以上の保磁力が得られることがわかった。図8と同様の傾向は、組成比が $0.4 \leq x \leq 0.6$ でかつ $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲にある、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 以外の全ての磁性層で得られた。

【0034】

次に、成膜中にガラス基板を $300 \sim 700^\circ\text{C}$ の各温度に加熱した状態で、ガラス基板上に、MgOからなる厚さ 10nm の下地層、厚さ 50nm の磁性層、カーボンからなる厚さ 5nm の保護層を成膜した。形成した磁性層は、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Cu)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Pd)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Au)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Sn) または $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Zn) である。成膜後のアニールは行わなかった。成膜後、上記と同様の方法で同様の評価を行った。

【0035】

図9は、基板温度 500°C で成膜した $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 磁性層について、組成 x と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.4 \leq x \leq 0.6$ の範囲で規則合金結晶の規則度が向上することがわかった。また、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Cu)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Pd)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Au)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Sn) および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Zn) のそれぞれの磁性層も、添加元素の固溶量にかかわらず上記と同様の傾向を示した。

【0036】

図10は、 $x=0.5$ 、 $y=6\text{at}\%$ である、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Cu)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Pd)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Au)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Sn) および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Zn) のそれぞれの磁性層について、成膜時の基板温度と規

則合金結晶の規則度 S との関係を示す。FePt 磁性層では基板温度 300°C では規則化が起こらず基板温度 400°C 以上で規則化が起こる。FePt に添加元素を添加した磁性層ではいずれも基板温度 300°C 以上で規則化が起こる。このように、添加元素の添加により低い基板温度で結晶粒の規則化が起こることがわかった。

【0037】

図11は、基板温度 300°C で成膜された $x = 0.5$ である $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Cu) 磁性層について、結晶粒内へのCuの固溶量 y [at %] と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で規則度の向上が確認された。他の添加元素についても同様の結果が得られた。

【0038】

図12は、基板温度 300°C で成膜された $x = 0.5$ である $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Cu) 磁性層について、結晶粒内へのCuの固溶量 y [at %] と基板面に対して垂直方向の K_u との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で $1 \times 10^7 \text{ erg/cc}$ 以上の高 K_u が得られた。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Pd)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Au)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Sn) および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Zn) のいずれの磁性層でも同様の結果が得られた。

【0039】

図13は、 $x = 0.5$ 、 $y = 6 \text{ at \%}$ である、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Cu)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Pd)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Au)、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Sn) および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Zn) のそれぞれの磁性層について、成膜時の基板温度と保磁力との関係を示す。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 以外の全ての磁性層において、 300°C 以上の基板温度で 7 kOe 以上の保磁力が得られることがわかった。図13と同様の傾向は、組成比が $0.4 \leq x \leq 0.6$ かつ $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲にある、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pt}_x$ 以外の全ての磁性層で得られた。

【0040】

実施例2

ガラス基板上に、MgOからなる厚さ 10 nm の下地層、厚さ 50 nm の磁性層、およびカーボンからなる厚さ 5 nm の保護層を成膜した。形成した磁性層は

、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ または $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ である。MgO 下地層は RF スパッタリングにより、磁性層および保護層は DC スパッタリングにより成膜した。磁性層は 5 mTorr 以上の圧力で二元または三元同時スパッタリングにより成膜し、その組成は各ターゲットへの投入電力を変化させて制御した。成膜中、基板加熱は行わなかった。成膜後、水素雰囲気中で 300～700℃ の範囲で 1 時間のアニールを行った。

【0041】

アニール後の磁性層の組成および磁気特性について実施例 1 と同様の方法で同様の測定を行った。規則合金結晶の規則度 S は、X 線回折によって得られた (001) および (002) 面による回折ピークの積分強度に基づいて次式により評価した。

【0042】

$$S = 1.23 (I_{001} / I_{002})^{1/2}$$

ここで、 I_{001} および I_{002} はそれぞれ (001) および (002) 面による回折ピークの積分強度である。

【0043】

図 14 は、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 媒体について、組成 x と 500℃ でアニールした後の規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。0.4 ≤ x ≤ 0.6 の範囲で規則合金結晶の規則度が向上することがわかった。また、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ のそれぞれの磁性層も、添加元素の固溶量にかかわらず上記と同様の傾向を示した。

【0044】

図 15 は、 $x = 0.5$ 、添加元素の固溶量 $y = 6 \text{ at } \%$ である、 FePd 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ のそれぞれの磁性層について、アニール温度と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 FePd 磁性層ではアニール温度 300℃ では規則化が起こらずアニール温度 400℃ 以上で規則化が起こる。 FePd に添加元素を添加した磁性層ではいずれもアニール温度 300℃ 以上で規則化が起こる。この

ように、添加元素の添加により低いアニール温度で結晶粒の規則化が起こることがわかった。

【0045】

図16は、300℃でアニールされた $x=0.5$ である $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 磁性層について、結晶粒内へのCuの固溶量 y [at%]と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で規則度の向上が確認された。他の添加元素についても同様の結果が得られた。

【0046】

図17は、300℃でアニールされた $x=0.5$ である $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 磁性層について、結晶粒内へのCuの固溶量 y [at%]と基板面に対して垂直方向の K_u との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で $1 \times 10^7 \text{ erg/cc}$ 以上の高 K_u が得られた。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ のいずれの磁性層でも同様の結果が得られた。

【0047】

図18は、 $x=0.5$ 、 $y=6 \text{ at\%}$ である、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ のそれぞれの磁性層について、アニール温度と保磁力との関係を示す。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 以外の全ての磁性層において、300℃以上のアニール温度で7kOe以上の保磁力が得られることがわかった。図18と同様の傾向は、組成比が $0.4 \leq x \leq 0.6$ でかつ $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲にある、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 以外の全ての磁性層で得られた。

【0048】

次に、成膜中にガラス基板を300～700℃の各温度に加熱した状態で、ガラス基板上に、MgOからなる厚さ10nmの下地層、厚さ50nmの磁性層、カーボンからなる厚さ5nmの保護層を成膜した。形成した磁性層は、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ または $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ である。成膜後のアニールは行わなかった。成膜後、上記と同様の方法で同様の評価を行った。

【0049】

図19は、基板温度500℃で成膜した $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 磁性層について、組成 x と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.4 \leq x \leq 0.6$ の範囲で規則合金結晶の規則度が向上することがわかった。また、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ のそれぞれの磁性層も、添加元素の固溶量にかかわらず上記と同様の傾向を示した。

【0050】

図20は、 $x=0.5$ 、 $y=6 \text{ at } \%$ である、 FePd 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ のそれぞれの磁性層について、成膜時の基板温度と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 FePd 磁性層では基板温度300℃では規則化が起こらず基板温度400℃以上で規則化が起こる。 FePd に添加元素を添加した磁性層ではいずれも基板温度300℃以上で規則化が起こる。このように、添加元素の添加により低い基板温度で結晶粒の規則化が起こることがわかった。

【0051】

図21は、基板温度300℃で成膜された $x=0.5$ である $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 磁性層について、結晶粒内への Cu の固溶量 $y [\text{at } \%]$ と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で規則度の向上が確認された。他の添加元素についても同様の結果が得られた。

【0052】

図22は、基板温度300℃で成膜された $x=0.5$ である $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 磁性層について、結晶粒内への Cu の固溶量 $y [\text{at } \%]$ と基板面に対して垂直方向の K_u との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で $1 \times 10^7 \text{ erg/cc}$ 以上の高 K_u が得られた。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ のいずれの磁性層でも同様の結果が得られた。

【0053】

図23は、 $x=0.5$ 、 $y=6 \text{ at } \%$ である、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Cu})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Au})$ 、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Sn})$ および $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x(\text{Zn})$ のそれぞれの磁性層について、成膜時の基板温度と保磁力との関係を示す。 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 以外の全ての磁性層において、300℃以上の基板温度で7kOe

以上の保磁力が得られることがわかった。図 2 3 と同様の傾向は、組成比が $0.4 \leq x \leq 0.6$ でかつ $0.1 \leq y \leq 5.0$ の範囲にある、 $\text{Fe}_{1-x}\text{Pd}_x$ 以外の全ての磁性層で得られた。

【 0 0 5 4 】

実施例 3

ガラス基板上に、 MgO からなる厚さ 10 nm の下地層、厚さ 50 nm の磁性層、およびカーボンからなる厚さ 5 nm の保護層を成膜した。形成した磁性層は、 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$ 、 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x(\text{Ni})$ および $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x(\text{Au})$ である。 MgO は RF スパッタリングにより、磁性層および保護層は DC スパッタリングにより成膜した。磁性層は 5 mTorr 以上の圧力で二元または三元同時スパッタリングにより成膜し、その組成は各ターゲットへの投入電力を変化させて制御した。成膜中、基板の加熱は行わなかった。成膜後、水素雰囲気中で $300 \sim 700^\circ\text{C}$ の範囲で 1 時間のアニールを行った。

【 0 0 5 5 】

アニール後の磁性層の組成および磁気特性について実施例 1 と同様の方法で同様の測定を行った。規則合金結晶の規則度 S は、X 線回折によって得られた (001) および (002) 面による回折ピークの積分強度に基づいて次式により評価した。

【 0 0 5 6 】

$$S = 0.74 \left(I_{001} / I_{002} \right)^{1/2}$$

ここで、 I_{001} および I_{002} はそれぞれ (001) および (002) 面による回折ピークの積分強度である。

【 0 0 5 7 】

図 2 4 は、 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$ 媒体について、組成 x と 500°C でアニールした後の規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.4 \leq x \leq 0.6$ の範囲で規則合金結晶の規則度が向上することがわかった。また、 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x(\text{Ni})$ および $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x(\text{Au})$ のそれぞれの磁性層も、添加元素の固溶量にかかわらず上記と同様の傾向を示した。

【 0 0 5 8 】

図 2 5 は、 $x = 0.5$ 、添加元素の固溶量 $y = 6 \text{ at } \%$ である、 CoPt 、 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x (\text{Ni})$ および $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x (\text{Au})$ のそれぞれの磁性層について、アニール温度と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 CoPt 磁性層ではアニール温度 300°C では規則化が起こらずアニール温度 400°C 以上で規則化が起こる。 CoPt に添加元素を添加した磁性層ではいずれもアニール温度 300°C 以上で規則化が起こる。このように、添加元素の添加により低いアニール温度で結晶粒の規則化が起こることがわかった。

【 0 0 5 9 】

図 2 6 は、 300°C でアニールされた $x = 0.5$ である $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x (\text{Ni})$ 磁性層について、結晶粒内への Ni の固溶量 $y [\text{at } \%]$ と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で規則度の向上が確認された。他の添加元素についても同様の結果が得られた。

【 0 0 6 0 】

図 2 7 は、 300°C でアニールされた $x = 0.5$ である $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x (\text{Ni})$ 磁性層について、結晶粒内への Ni の固溶量 $y [\text{at } \%]$ と基板面に対して垂直方向の K_u との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で $1 \times 10^7 \text{ erg/cc}$ 以上の高 K_u が得られた。 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x (\text{Au})$ 磁性層でも同様の結果が得られた。

【 0 0 6 1 】

図 2 8 は、 $x = 0.5$ 、 $y = 6 \text{ at } \%$ である、 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$ 、 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x (\text{Ni})$ および $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x (\text{Au})$ のそれぞれの磁性層について、アニール温度と保磁力との関係を示す。 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$ 以外の全ての磁性層において、 300°C 以上のアニール温度で 7 kOe 以上の保磁力が得られることがわかった。図 2 8 と同様の傾向は、組成比が $0.4 \leq x \leq 0.6$ かつ $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲にある、 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$ 以外の全ての磁性層で得られた。

【 0 0 6 2 】

次に、成膜中にガラス基板を $300 \sim 700^\circ\text{C}$ の各温度に加熱した状態で、ガラス基板上に、 MgO からなる厚さ 10 nm の下地層、厚さ 50 nm の磁性層、カーボンからなる厚さ 5 nm の保護層を成膜した。形成した磁性層は、 Co_{1-x}

Pt_x 、 $Co_{1-x}Pt_x(Ni)$ および $Co_{1-x}Pt_x(Au)$ である。成膜後のアニールは行わなかった。成膜後、上記と同様の方法で同様の評価を行った。

【0063】

図29は、基板温度500℃で成膜した $Co_{1-x}Pt_x$ 磁性層について、組成 x と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.4 \leq x \leq 0.6$ の範囲で規則合金結晶の規則度が向上することがわかった。また、 $Co_{1-x}Pt_x(Ni)$ および $Co_{1-x}Pt_x(Au)$ のそれぞれの磁性層も、添加元素の固溶量にかかわらず上記と同様の傾向を示した。

【0064】

図30は、 $x=0.5$ 、 $y=6 \text{ at \%}$ である、 $CoPt$ 、 $Co_{1-x}Pt_x(Ni)$ および $Co_{1-x}Pt_x(Au)$ のそれぞれの磁性層について、成膜時の基板温度と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $CoPt$ 磁性層では基板温度300℃では規則化が起こらず基板温度400℃以上で規則化が起こる。 $CoPt$ に添加元素を添加した磁性層ではいずれも基板温度300℃以上で規則化が起こる。このように、添加元素の添加により低い基板温度で結晶粒の規則化が起こることがわかった。

【0065】

図31は、基板温度300℃で成膜された $x=0.5$ である $Co_{1-x}Pt_x(Ni)$ 磁性層について、結晶粒内への Ni の固溶量 $y [\text{at \%}]$ と規則合金結晶の規則度 S との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で規則度の向上が確認された。他の添加元素についても同様の結果が得られた。

【0066】

図32は、基板温度300℃で成膜された $x=0.5$ である $Co_{1-x}Pt_x(Ni)$ 磁性層について、結晶粒内への Ni の固溶量 $y [\text{at \%}]$ と基板面に対して垂直方向の Ku との関係を示す。 $0.1 \leq y \leq 50$ の範囲で $1 \times 10^7 \text{ erg/cc}$ 以上の高 Ku が得られた。 $Co_{1-x}Pt_x(Au)$ 磁性層でも同様の結果が得られた。

【0067】

図33は、 $x=0.5$ 、 $y=6 \text{ at \%}$ である、 $Co_{1-x}Pt_x$ 、 $Co_{1-x}Pt_x($

Ni) および $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$ (Au) のそれぞれの磁性層について、成膜時の基板温度と保磁力との関係を示す。 $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$ 以外の全ての磁性層において、300℃以上の基板温度で7kOe以上の保磁力が得られることがわかった。図33と同様の傾向は、組成比が $0.4 \leq x \leq 0.6$ かつ $0.1 \leq y \leq 5.0$ の範囲にある $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$ 以外の全ての磁性層で得られた。

【0068】

【発明の効果】

以上詳述したように本発明によれば、低い基板温度またはアニール温度で規則相を形成でき、高密度化に好適な高Kuを示す磁気記録媒体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る磁気記録媒体の断面図。

【図2】

FePtX規則相の結晶構造を示す模式図。

【図3】

FePt不規則相の結晶構造を示す模式図。

【図4】

実施例1の磁気記録媒体について、組成と規則度との関係を示す図。

【図5】

実施例1の磁気記録媒体について、アニール温度と規則度との関係を示す図。

【図6】

実施例1の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と規則度との関係を示す図。

【図7】

実施例1の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量とKuとの関係を示す図。

【図8】

実施例1の磁気記録媒体について、アニール温度と保磁力との関係を示す図。

【図 9】

実施例 1 の磁気記録媒体について、組成と規則度との関係を示す図。

【図 1 0】

実施例 1 の磁気記録媒体について、成膜時の基板温度と規則度との関係を示す図。

【図 1 1】

実施例 1 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と規則度との関係を示す図。

【図 1 2】

実施例 1 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と K_u との関係を示す図。

【図 1 3】

実施例 1 の磁気記録媒体について、成膜時の基板温度と保磁力との関係を示す図。

【図 1 4】

実施例 2 の磁気記録媒体について、組成と規則度との関係を示す図。

【図 1 5】

実施例 2 の磁気記録媒体について、アニール温度と規則度との関係を示す図。

【図 1 6】

実施例 2 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と規則度との関係を示す図。

【図 1 7】

実施例 2 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と K_u との関係を示す図。

【図 1 8】

実施例 2 の磁気記録媒体について、アニール温度と保磁力との関係を示す図。

【図 1 9】

実施例 2 の磁気記録媒体について、組成と規則度との関係を示す図。

【図 2 0】

実施例 2 の磁気記録媒体について、成膜時の基板温度と規則度との関係を示す図。

【図 2 1】

実施例 2 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と規則度との関係を示す図。

【図 2 2】

実施例 2 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と K_u との関係を示す図。

【図 2 3】

実施例 2 の磁気記録媒体について、成膜時の基板温度と保磁力との関係を示す図。

【図 2 4】

実施例 3 の磁気記録媒体について、組成と規則度との関係を示す図。

【図 2 5】

実施例 3 の磁気記録媒体について、アニール温度と規則度との関係を示す図。

【図 2 6】

実施例 3 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と規則度との関係を示す図。

【図 2 7】

実施例 3 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と K_u との関係を示す図。

【図 2 8】

実施例 3 の磁気記録媒体について、アニール温度と保磁力との関係を示す図。

【図 2 9】

実施例 3 の磁気記録媒体について、組成と規則度との関係を示す図。

【図 3 0】

実施例 3 の磁気記録媒体について、成膜時の基板温度と規則度との関係を示す図。

【図 3 1】

実施例 3 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と規則度との関係を示す図。

【図 3 2】

実施例 3 の磁気記録媒体について、添加元素の固溶量と K_u との関係を示す図。

【図 3 3】

実施例 3 の磁気記録媒体について、成膜時の基板温度と保磁力との関係を示す図。

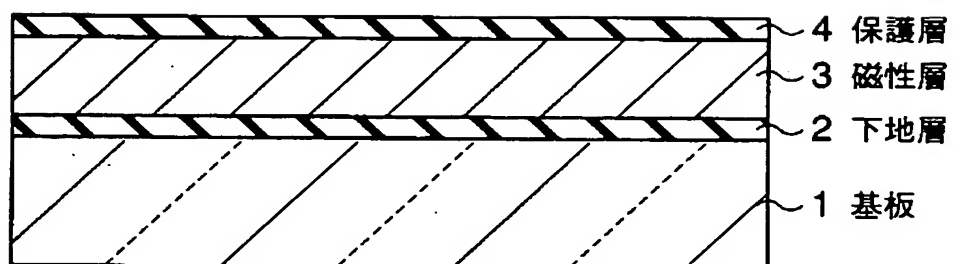
【符号の説明】

- 1 … 基板
- 2 … 下地層
- 3 … 磁性層
- 4 … 保護層

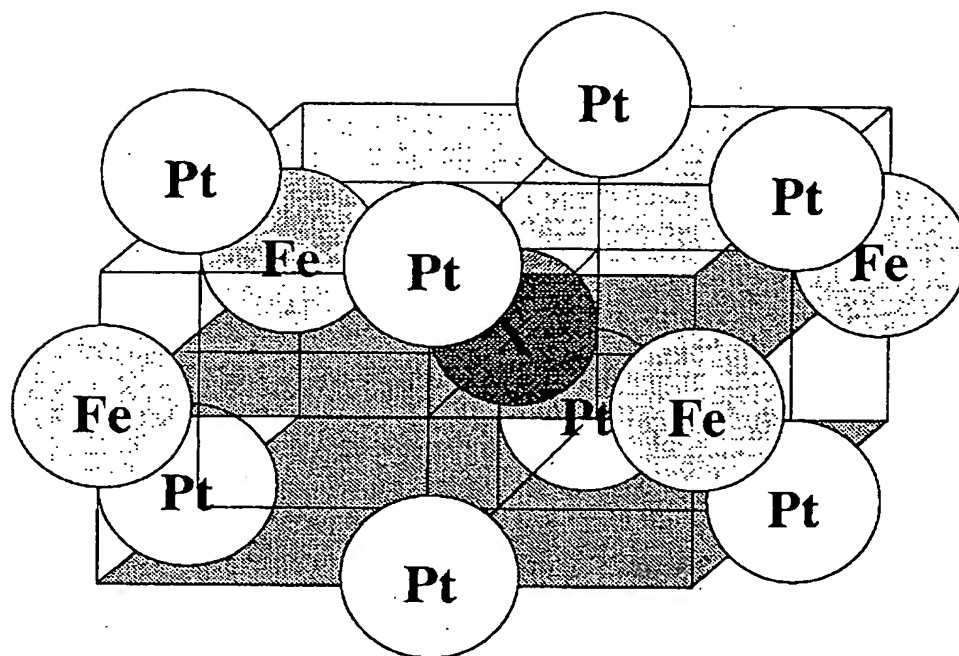
【書類名】

図面

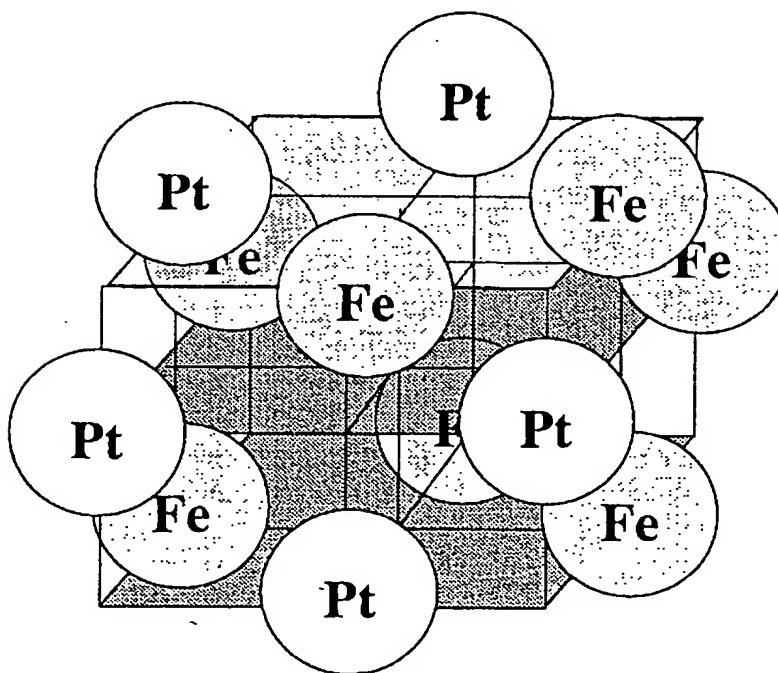
【図 1】



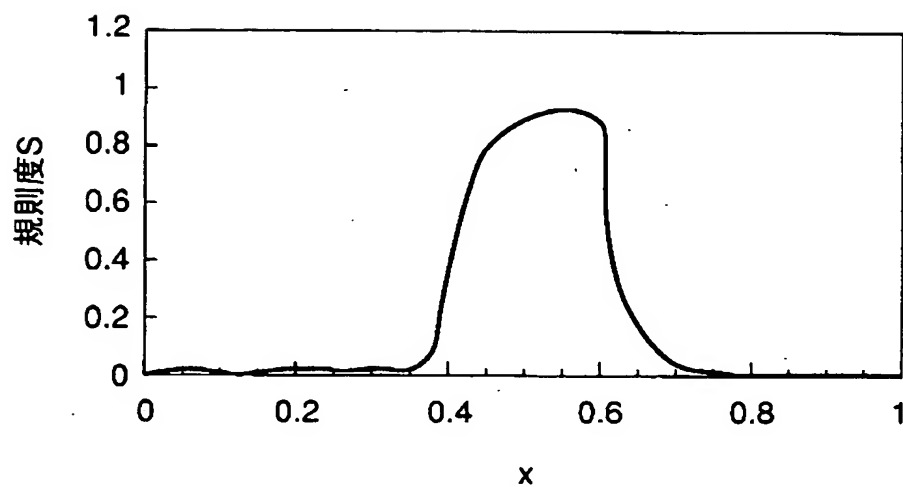
【図 2】



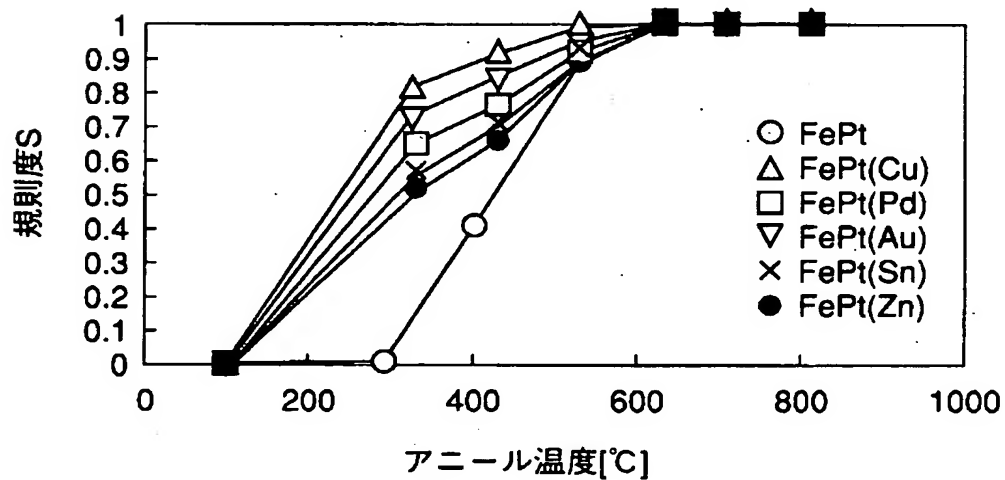
【図 3】



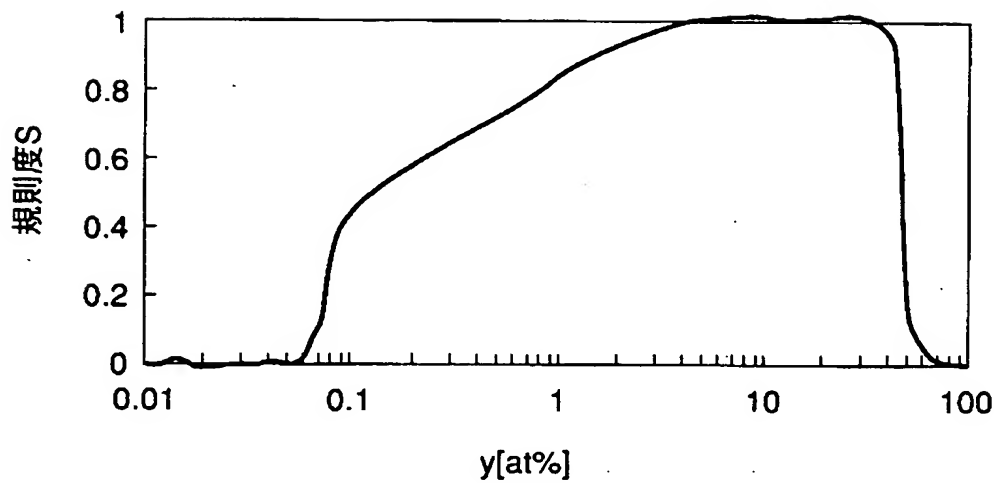
【図 4】



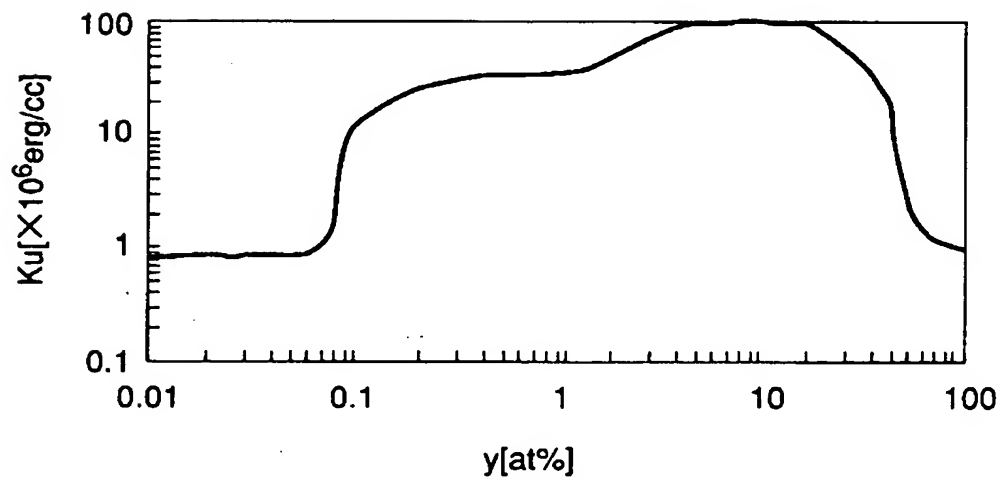
【図 5】



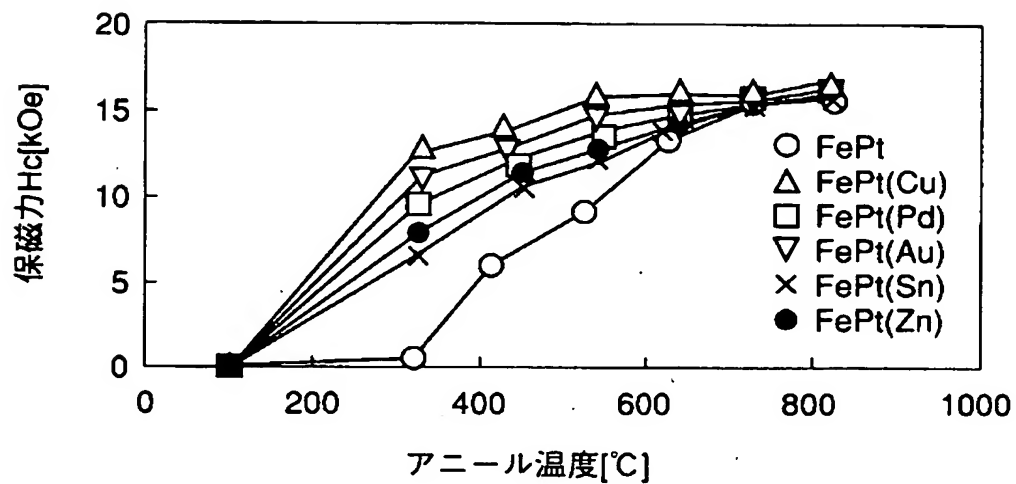
【図 6】



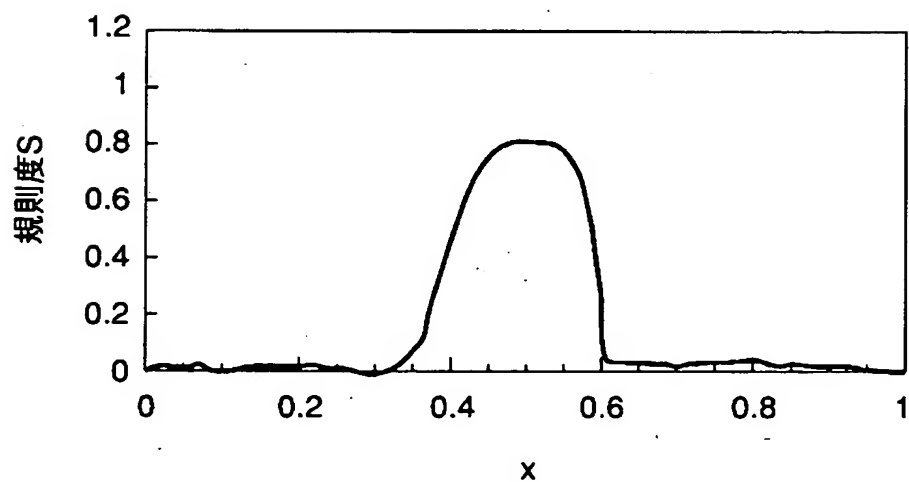
【図 7】



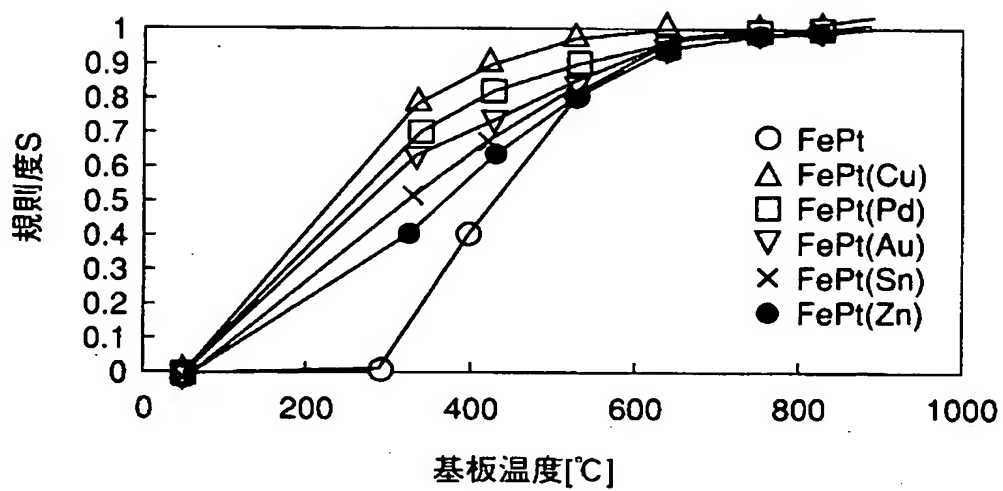
【図 8】



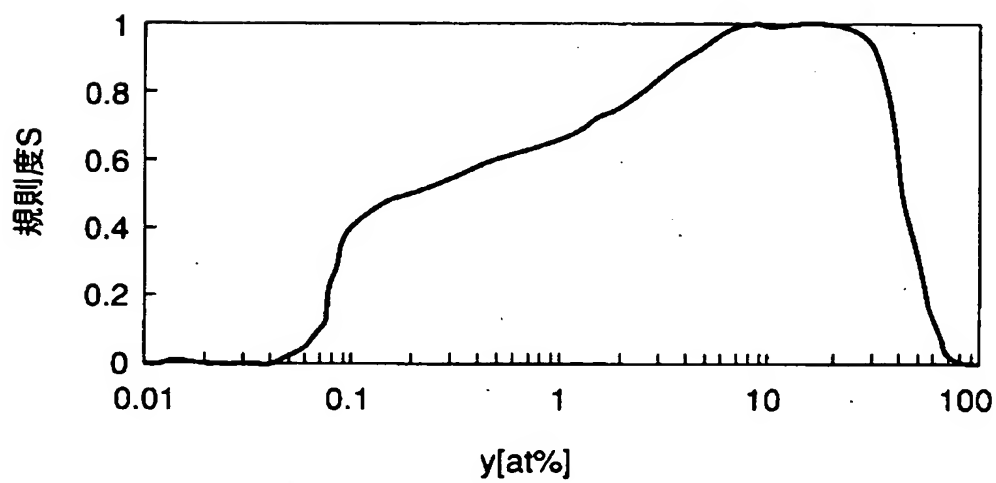
【図 9】



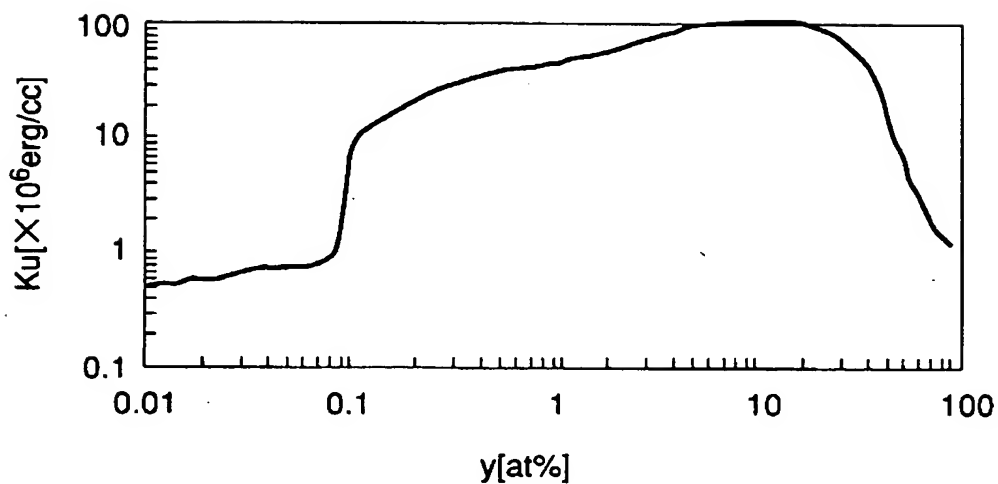
【図 1 0】



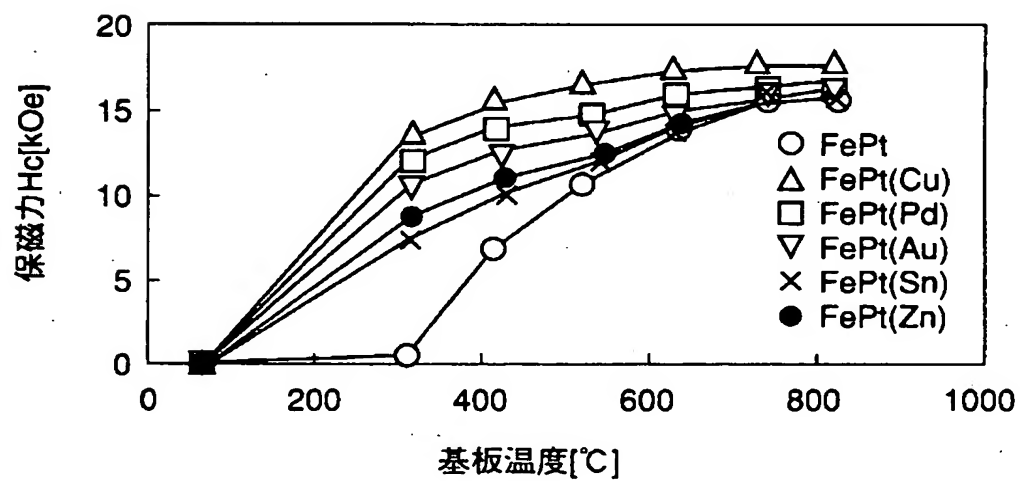
【図 1 1】



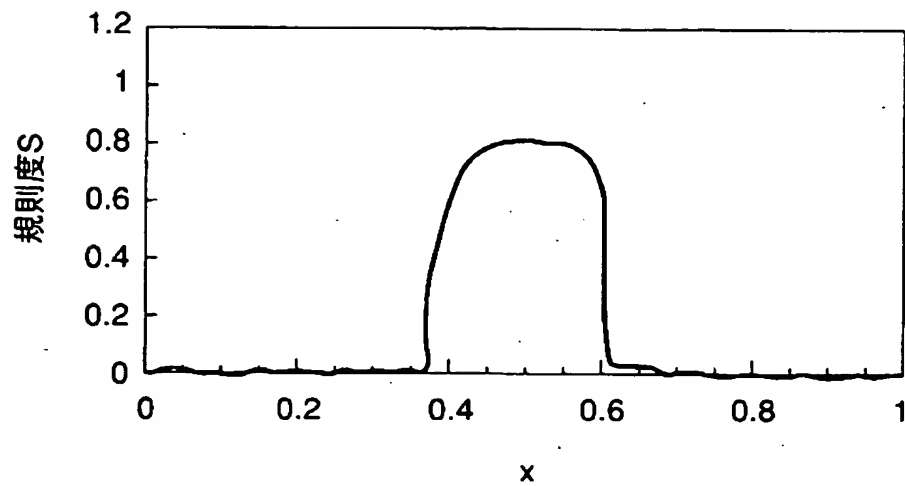
【図 1 2】



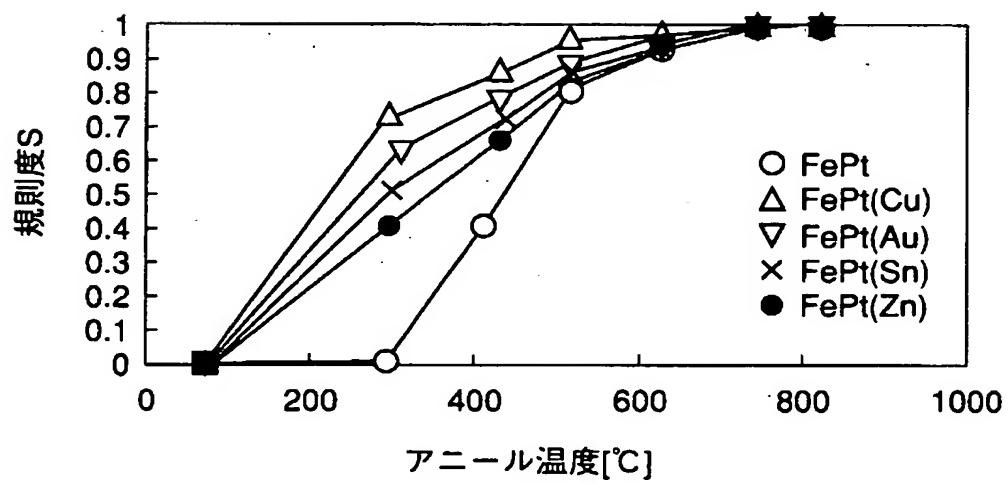
【図 1 3】



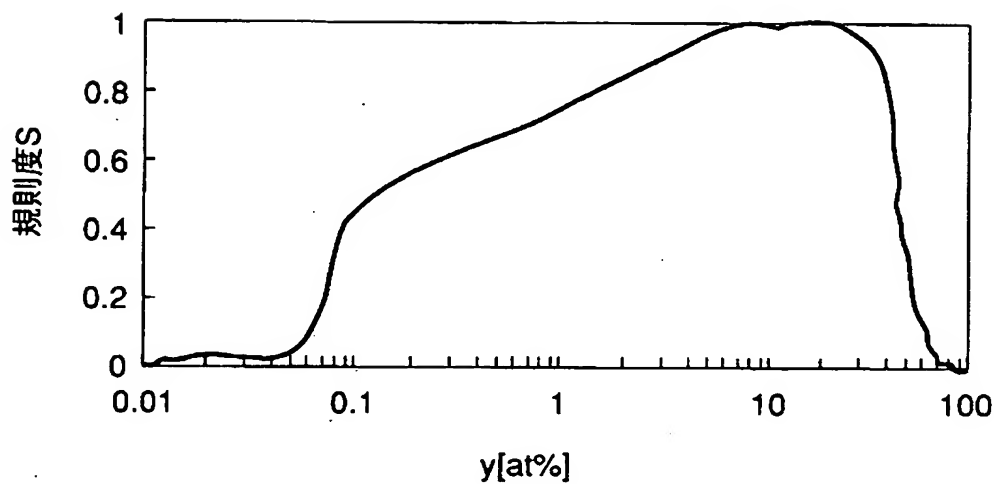
【図 14】



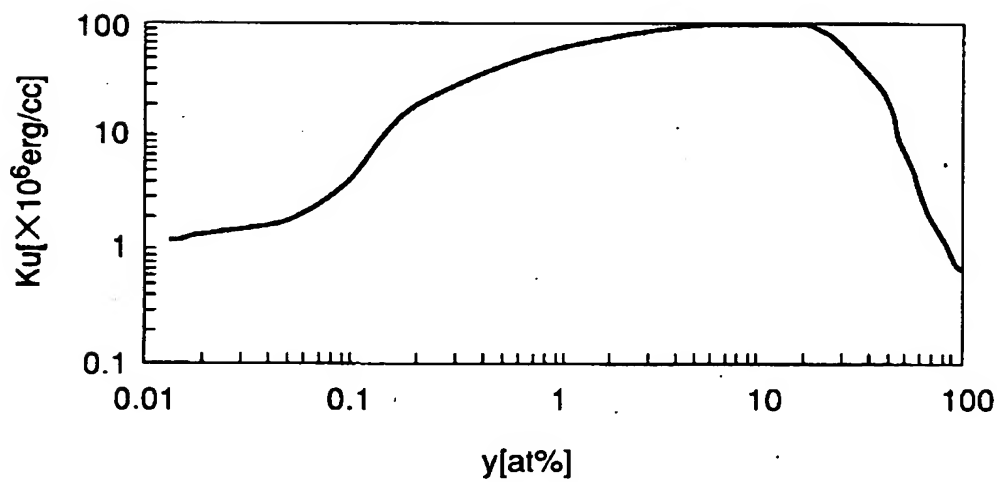
【図 15】



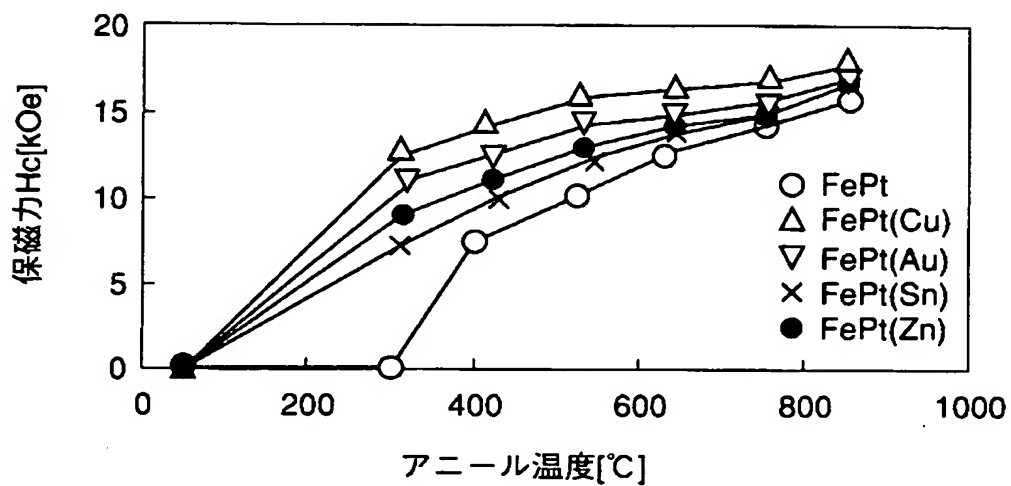
【図 16】



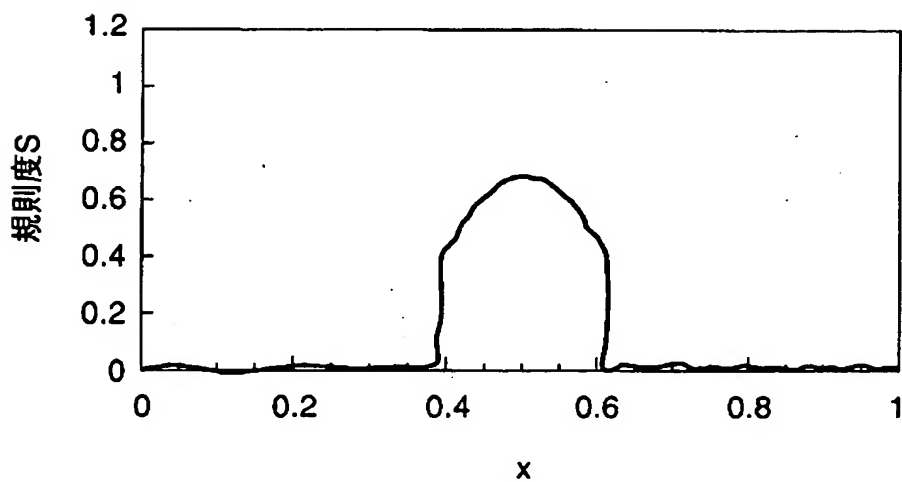
【図 17】



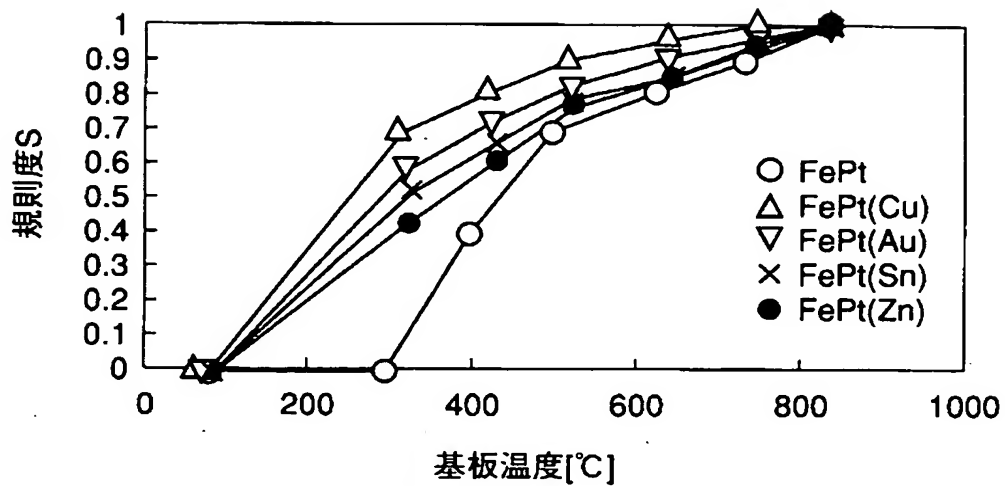
【図18】



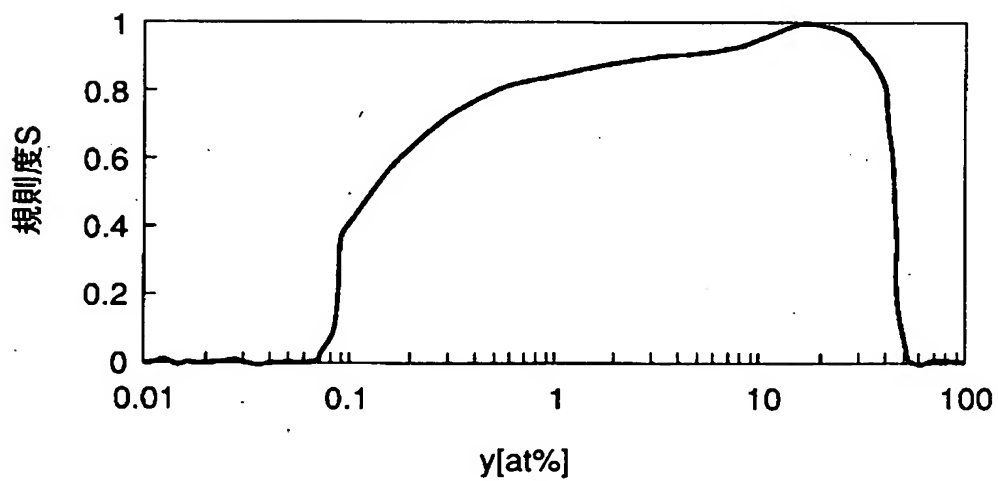
【図19】



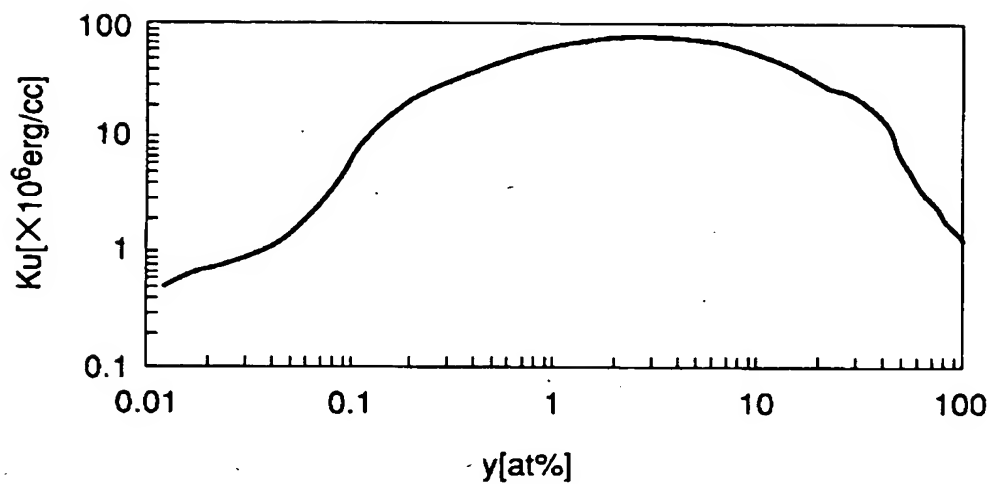
【図 2 0】



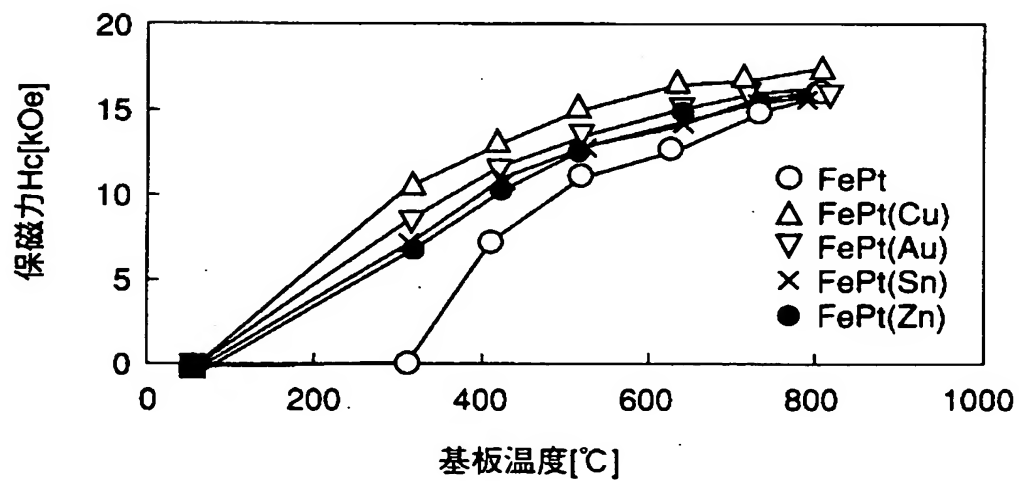
【図 2 1】



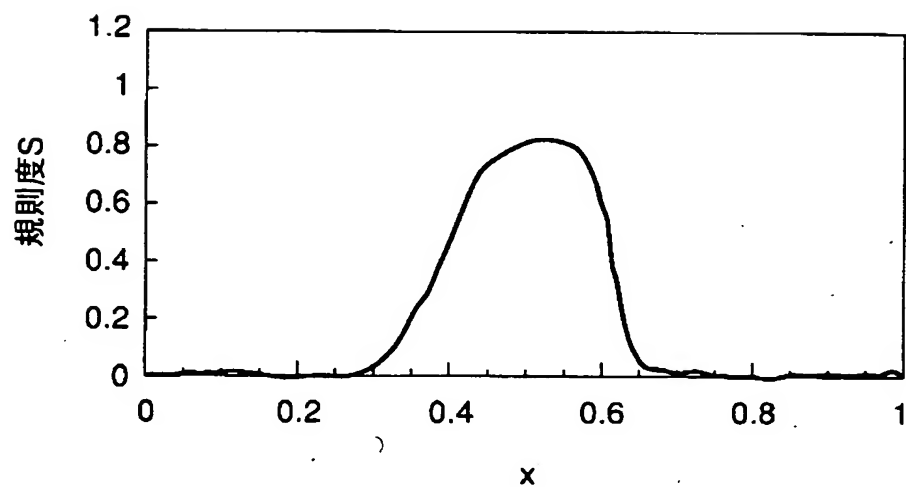
【図 2 2】



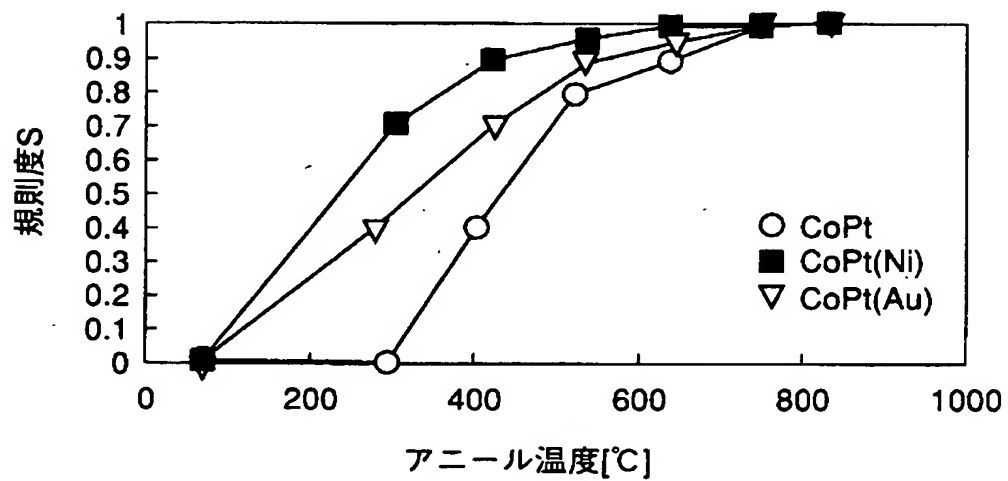
【図 2 3】



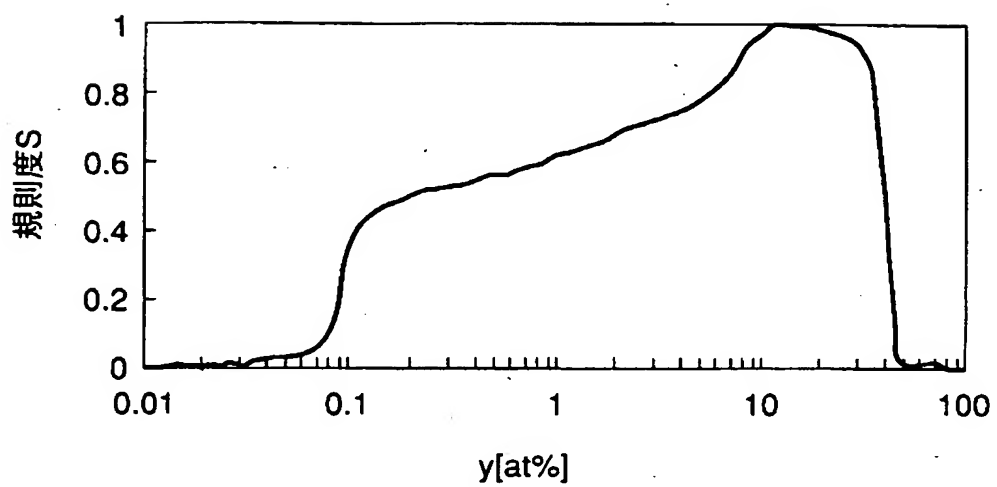
【図 24】



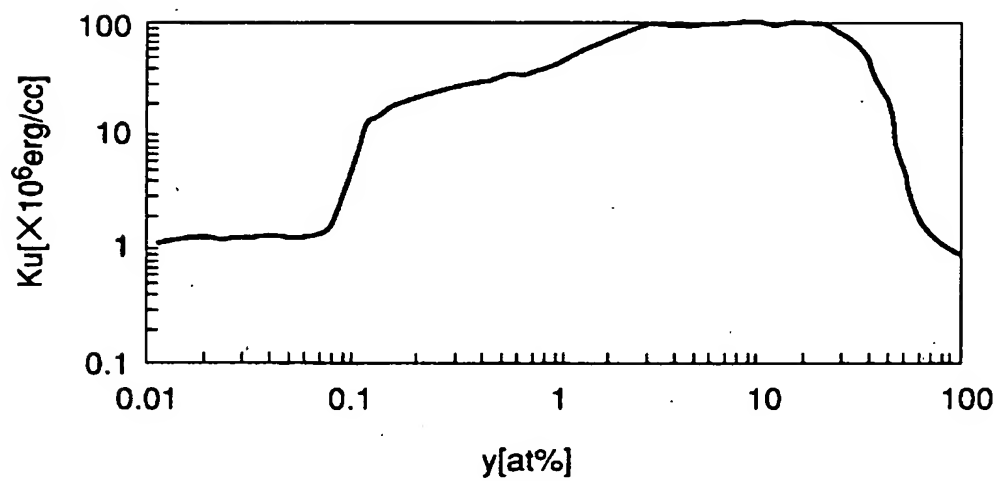
【図 25】



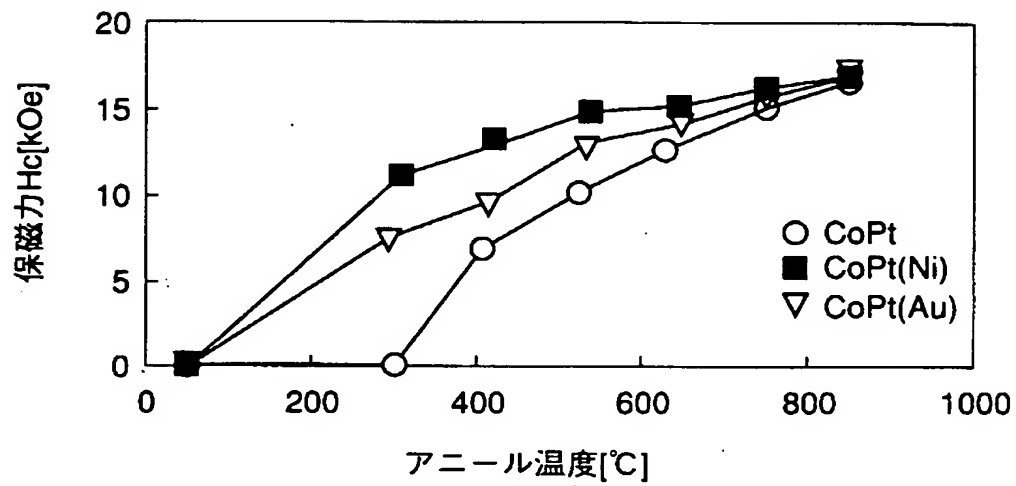
【図 26】



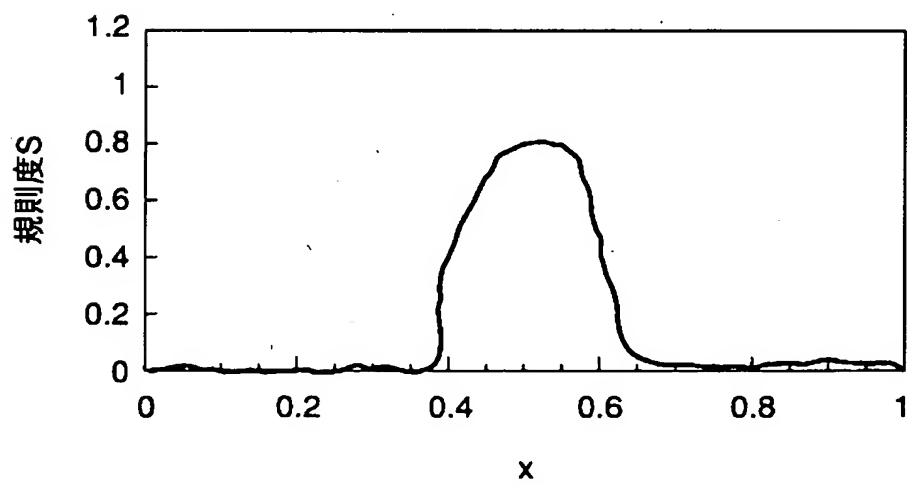
【図 27】



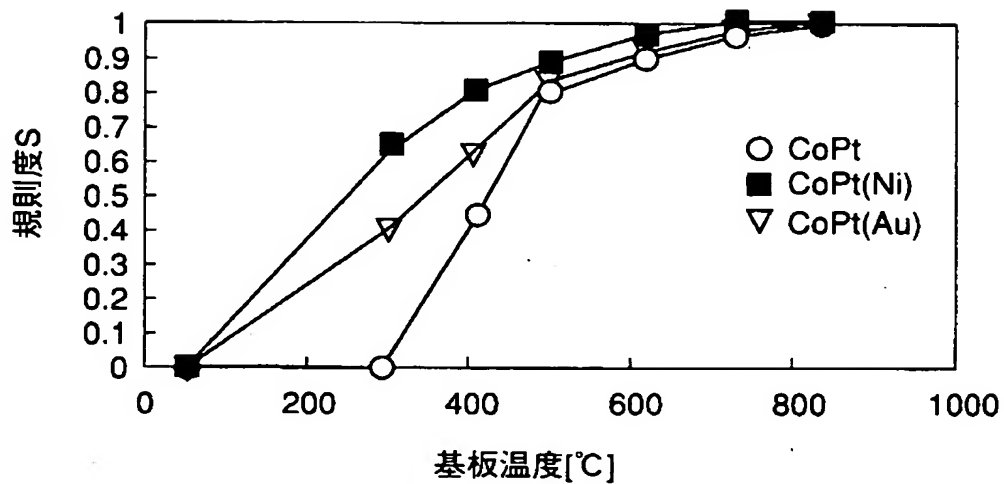
【図 28】



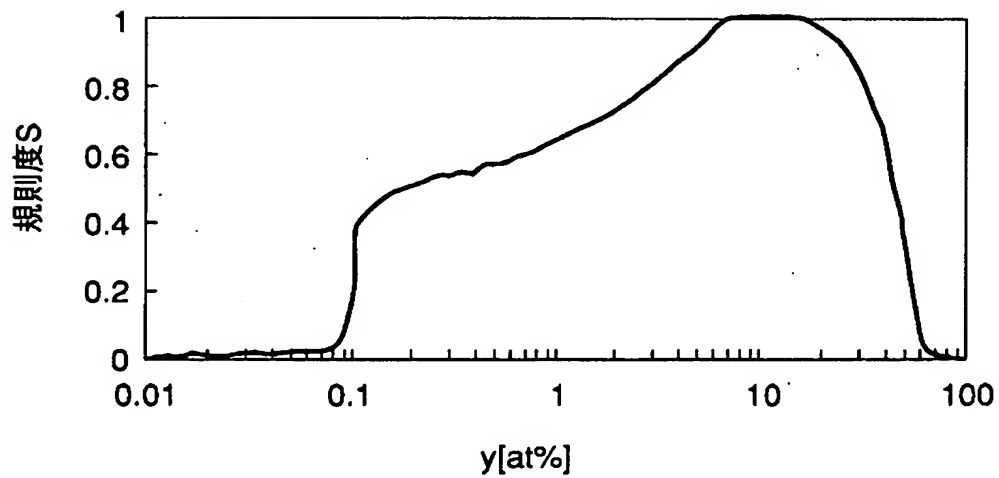
【図 29】



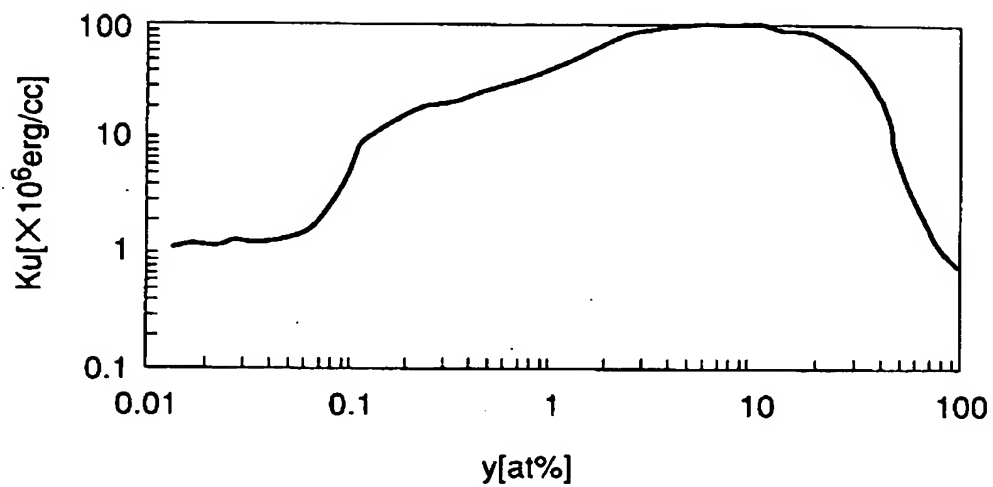
【図 30】



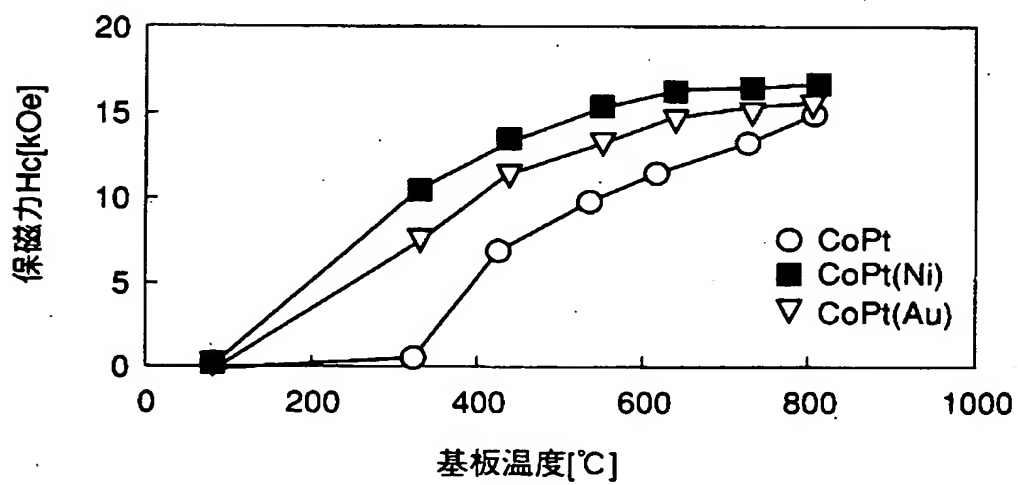
【図 31】



【図 3 2】



【図 3 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低い成膜温度または低いアニール温度で形成でき、かつ高Kuを有する規則合金結晶を磁性層とする磁気記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板と、基板上に形成された下地層と、下地層上に形成された磁性層と、磁性層上に形成された保護層とを具備し、磁性層はFeおよびPt、FeおよびPd、またはCoおよびPtを主成分とするL1₀構造を有する結晶粒からなり、結晶粒内に少なくとも一種の添加元素が0.1から50原子パーセントの範囲で固溶している。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003078]

1. 変更年月日 1990年 8月22日
[変更理由] 新規登録
住 所 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
氏 名 株式会社東芝

2. 変更年月日 2001年 7月 2日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都港区芝浦一丁目1番1号
氏 名 株式会社東芝